

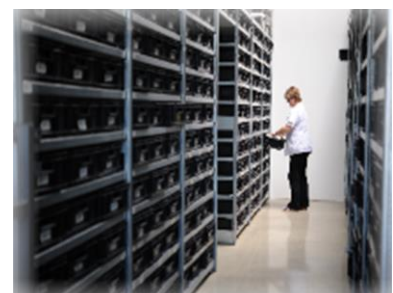
Informationen über das Leistungsspektrum der TSE Dresden GmbH

Die TSE Dresden GmbH ist zertifiziert gemäß dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001. Sie realisiert im Auftrag ihrer Kunden die RoHS- konforme sowie bleihaltige Fertigung in verschiedenen Aufbau- und Verbindungstechniken.

Sie bestückt auf Ein- und Mehrlagenleiterplatten bis hin zu Starr-Flex Leiterplatten. Die Fertigung der TSE Dresden GmbH arbeitet gemäß der IPC-A-610 Norm. Alle Produktionsbereiche sind ESD-gerecht gestaltet.

Professionelle Fertigungsdienstleistungen

- Logistik
 - Internationaler Einkauf zur Sicherung der Bauelementedeckung pro Auftrag
 - Internes Supply-Chain-Management (SCM) bis zur Lieferung
 - Traceability und Etikettierung der Baugruppen
 - Lagerservice der Kundenprodukte
- Entwicklungsleistung
 - Unterstützung bei der Optimierung des Leiterplattenlayouts
 - Alternative Bauelementeauswahl
 - Einsatz normgerechter ESD- und Pendel-Verpackungen
- Prototyping/Vorserien
 - Grundsätzliche Erstellung eines EMPB
 - Prüfung der Baugruppen auf Einhaltung fertigungstechnologischer Richtlinien
 - Einsatz kostengünstiger Musterbauschablonen für den automatisierten Lotpastendruck (max. Platinenmaße: 196mm x 296mm)
- Serienfertigung
 - Fertigung in flexiblen Produktionslosen für Groß-, Mittel- oder Kleinserien



- Gerätemontage
 - Einbau und Montage der bestückten Baugruppe in unterschiedliche Systemgehäuse
 - Kabel- und Stecker montagen in kundenspezifische Gehäuseteile
- Baugruppenprüfung
 - Funktionstest
 - IC-Programmierung (EPROM,EEPROM,GAL's,MC's)
 - Hochspannungs- und Isolationstest
 - Schutzleitertest
- Serviceleistungen
 - Reparatur von 'Feldrückläufern' (After-Sales-Service)
 - Reworkarbeiten auf Baugruppen aus Fremdfertigung
- SMT-Bestückung
 - Bestückung mit Bauteilen der Bauformen ab 0201 sowie u.a. QFN,BGA, μ BGA,CSP, Finepitch-IC's, Kontaktleisten
 - Durchgängiger Fertigungsprozess mit Schablonendruck für Lotpaste und Kleber
 - Umluft-Reflow-Lötprozess
- THT-Bestückung
 - Bauteile in Durchstecktechnik werden konventionell gesetzt
 - Verwendete Technologien sind das RoHS-konforme sowie verbleite Hand- und Wellenlötten
- Oberflächenversiegelung
 - Manuelle Baugruppenlackierung komplett



Informationen über das Ausrüstungsspektrum der TSE Dresden GmbH

Dieses Blatt gibt Ihnen einen Überblick über die im Fertigungsprozess befindlichen Ausrüstungen bei der TSE Dresden GmbH. Durch die moderne SMT- Produktionslinie werden die Platinen rationell und sicher bestückt.

Die SMT-Technologie für Platinenmaße inkl. Rand:

- max. 300x410 / mind. 90x90, sonst Nutzen oder 'Trägerboard'
 - DEK Horizon 03i inline für Lotpasten- und SMD-Kleber
 - UNIVERSAL AdVantisX AS7 Bestückautomat
 - UNIVERSAL AdVantis 3AC-30S -Bestückautomat
 - Rehm VXC nitro 2450 Reflow- Konvektionsofen
 - PTP® (Professional Temperatur Profiler)-Messsystem zur Anlagenprüfung gem. ISO9001 bzw. Lötprofil-Optimierung



Die THT-Technologie für Platinenmaße inkl. Rand:

- max. 250x430
 - SEHO PowerWave N2 für bleifreies und verbleites Wellen-Löten unter N₂
 - ROYONIC Lichtpunktbestücktische
 - PTP® (Professional Temperatur Profiler)-Messsystem zur Anlagenprüfung gem. ISO9001 bzw. Lötprofil-Optimierung



Die Handfertigung u.a. für Sonderbauformen:

- Infrarot- Reworkstation Xytronic für SMD- Bauelemente
- WELLER Handlötstationen u.a. mit Heißluft
- JBC- Handlötstationen mit elektronisch geregelter Temperaturprofil
- Wärmeschrank WSU400
- Nutzen- und Stegtrenner
- diverse Macroskope, Mikroskope, Lupen



Prüfung und Programmierung:

- Hochspannungs- und Isolationstest bis 5kV; DC/AC
- Programmierung auf DATA iO (u.a. EPROM, EEPROM, GAL's und MC's)
- In-Circuit-Test mit individuellem Prüfadapter auf IRF für max. 1280 Testpunkte

